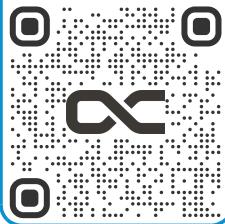




Alphacool Apex Thermal Putty X1 30g

Alphacool Artikelnummer: 14828

Download Center



Kurzinformation

Das Alphacool Apex Thermal Putty ist eine leistungsstarke Lösung, um hitze-empfindliche elektronische Bauteile thermisch mit an den Kühlkörper anzubinden. Als nicht aushärtendes Silikongel stellt es eine elektrisch nichtleitende Alternative zu klassischen Wärmeleitpads dar und wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen Flexibilität, geringe mechanische Belastung und eine hohe Wärmeleitfähigkeit entscheidend sind.

- Wärmeleitfähigkeit: 10 W/mK
- Hohe Kompressibilität für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung
- Kein Pump-out, kein Reißen oder Verrutschen
- Ideal für Grafikkartenkühler

Lieferumfang

1x Alphacool Apex Thermal Putty X1 30g

Technische Daten

Fließrate (g/min)	20 (Prüfmethode: 30-cc-EFD-Kartusche / 2,5-mm-Düse, 90 psi)
Dichte (g/cc)	3.8 (Prüfmethode: ASTM D792)
Minimale Bondline-Dicke (mm)	0.2mm
Dauergebrauchstemperatur (Grad Celsius)	-20 bis 125 °C
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	10 (Prüfmethode: ASTM D5470)
Volumenwiderstand (Ohm·cm)	>/= 1,0 × 10 ¹³ (Prüfmethode: ASTM D257)
Durchschlagfestigkeit (kV/mm)	>/= 5 (Prüfmethode: ASTM D149)
Gewicht	30g
Farbe	Blau-Grau

Download Links

Sicherheitsdatenblatt	14828_Alphacool_Apex_Thermal_Putty_X1_30g_SDB.pdf
Produktbilder	14828_Alphacool_Apex_Thermal_Putty_X1_30g_pics.zip

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	57 x 50 x 35 mm
Gesamtgewicht	48 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197148283
Zoll Nummer	84733080000

Artikeltext

Das Alphacool Apex Thermal Putty ist eine leistungsstarke Lösung, um hitze-empfindliche elektronische Bauteile thermisch mit an den Kühlkörper anzubinden. Als nicht aushärtendes Silikongel stellt es eine elektrisch nichtleitende Alternative zu klassischen Wärmeleitpads dar und wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen Flexibilität, geringe mechanische Belastung und eine hohe Wärmeleitfähigkeit entscheidend sind.

Ein zentraler Vorteil des Apex Thermal Putty liegt in seiner optimalen Konsistenz für Verarbeitung und Formstabilität. Das Material passt sich unter leichtem Druck optimal an unterschiedliche Spalthöhen an und bleibt dennoch formstabil. Dadurch können Unebenheiten und Toleranzen zwischen Kühlkörper und Bauteil zuverlässig ausgeglichen werden, wodurch stets ein optimaler Kontakt zwischen Wärmequelle und Kühlkörper sichergestellt wird. Dies ist insbesondere bei modernen Grafikkarten und anderen sensiblen elektronischen Komponenten von großer Bedeutung, da empfindliche Bauteile wie Speicherchips oder Spannungswandler so vor Schäden geschützt werden.

Das ausgeklügelte Formuladesign des Alphacool Apex Thermal Putty kombiniert hohe Wärmeleitfähigkeit mit einer reduzierten Bond Line Thickness (BLT), wodurch der thermische Widerstand gesenkt und die Wärmeabfuhr verbessert wird. Die Bond Line Thickness beschreibt dabei die Dicke der Wärmeleitmaterialschicht zwischen Bauteil und Kühlkörper. Gleichzeitig sorgt die hohe vertikale Stabilität bei langfristig stabilen Materialeigenschaften für eine dauerhafte Materialintegrität ohne Absacken, Rissbildung oder Kontamination angrenzender Bauteile, was das Produkt ideal für professionelle Anwendungen macht.

Aufgrund dieser Eigenschaften findet das Alphacool Apex Thermal Putty ein breites Einsatzspektrum. Überall dort, wo eine zuverlässige, flexible und mechanisch schonende Wärmeübertragung erforderlich ist, bietet das Apex Putty eine leistungsstarke und zukunftssichere Lösung.